

# Analog Devices Welcomes Hittite Microwave Corporation

NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



**THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK**

### Typical Applications

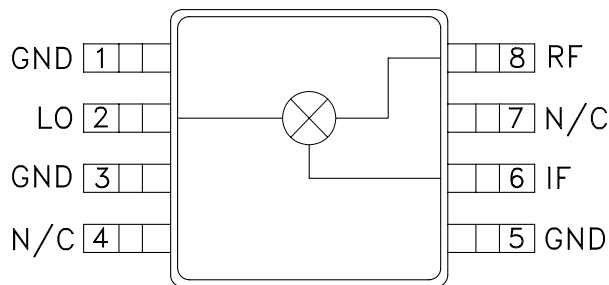
The HMC272AMS8 / HMC272AMS8E is ideal for:

- Up or Down Converter for PCS
- W-CDMA
- 2.4 GHz ISM
- MMDS

### Features

- RoHS Compliant Product
- Ultra Small Package: MSOP8
- LO / RF Isolation: 32 dB
- Input IP3: +20 dBm

### Functional Diagram



### General Description

The HMC272AMS8 & HMC272AMS8E are general purpose ultra miniature single balanced mixers in 8 lead plastic surface mount Mini Small Outline Packages (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and a novel planar transformer balun on the chip. The RF port is balanced via the MMIC balun while the LO port is connected directly to the diodes. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance.

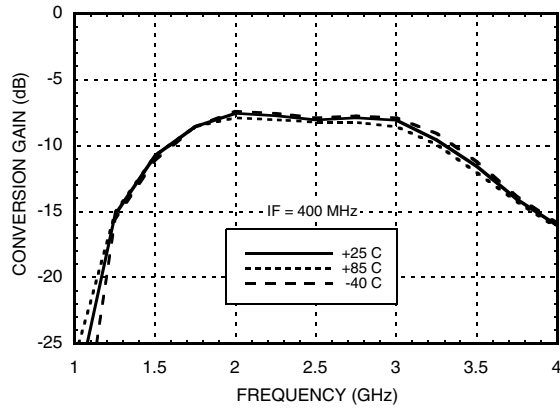
### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ \text{C}$ , As a Function of IF Frequency

Parameter	LO = +10 dBm IF = 100 MHz			LO = +10 dBm IF = 400 MHz			Units
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
Frequency Range, RF & LO	2 - 3			1.7 - 2.8			GHz
Frequency Range, IF	DC - 0.8			DC - 0.8			GHz
Conversion Loss		9	10.5		9	11	dB
Noise Figure (SSB)		9	10.5		9	11	dB
LO to RF Isolation	22	30		24	32		dB
LO to IF Isolation	12	20		11	18		dB
IP3 (Input)	17	21		16	20		dBm
1 dB Compression (Input)	8	11		7	10		dBm

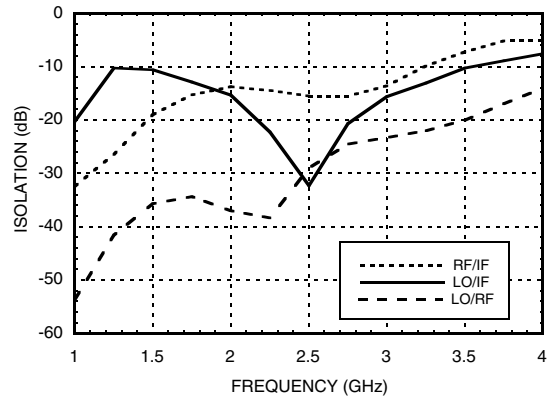


## GaAs MMIC SMT SINGLE BALANCED MIXER, 1.7 - 3.0 GHz

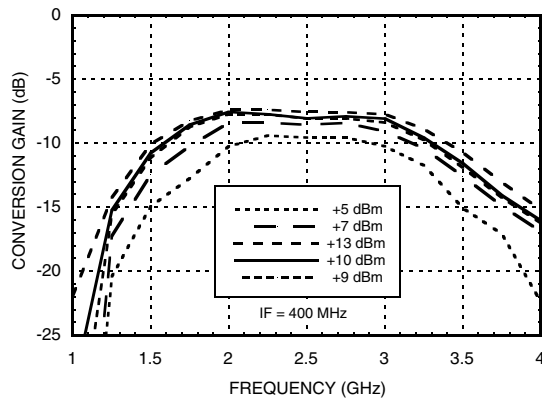
**Conversion Gain vs. Temperature @ LO = +10 dBm**



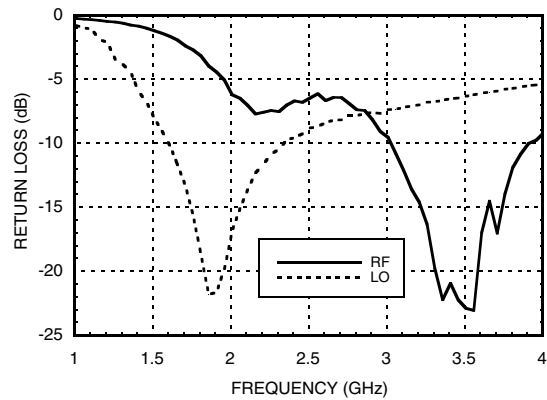
**Isolation @ LO = +10 dBm**



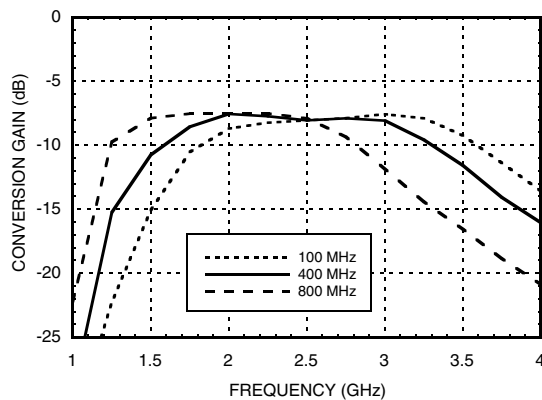
**Conversion Gain vs. LO Drive**



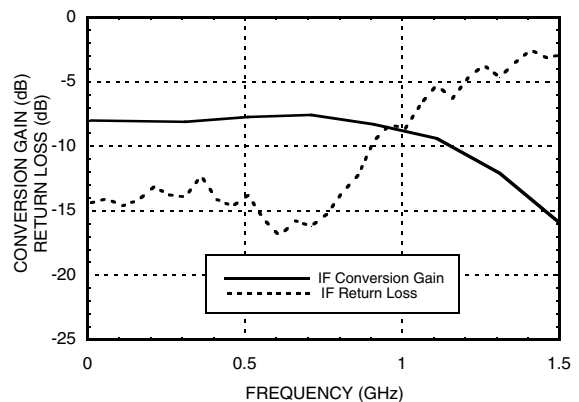
**Return Loss @ LO = +10 dBm**

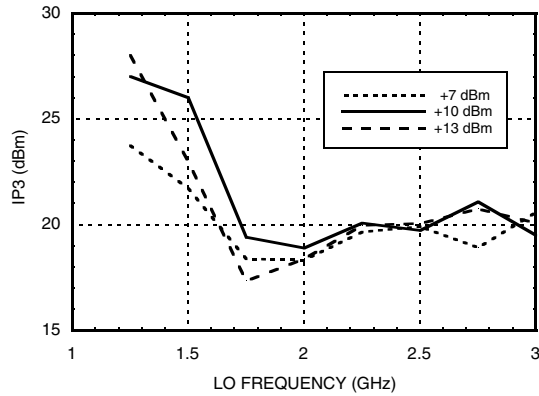
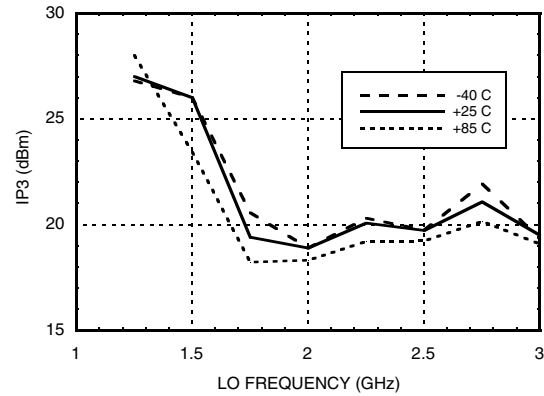
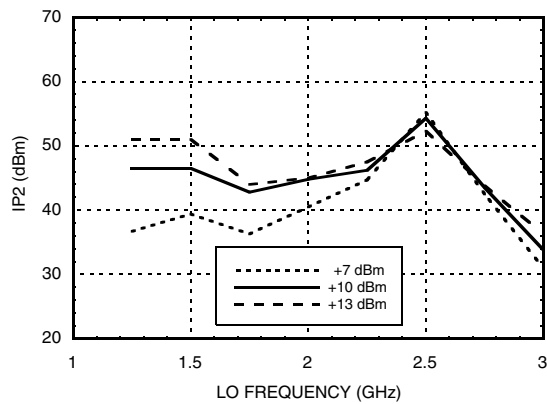
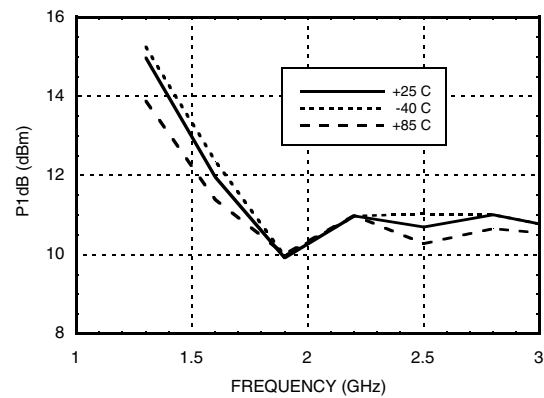


**Conversion Gain vs. IF Frequency**



**IF Bandwidth @ LO = +10 dBm vs. Conversion Gain & Return Loss**




**GaAs MMIC SMT SINGLE  
BALANCED MIXER, 1.7 - 3.0 GHz**
**Input IP3 vs. LO Drive**

**Input IP3 vs.  
Temperature @ LO = +10 dBm**

**Input IP2 vs. LO Drive**

**P1dB vs.  
Temperature @ LO = +10 dBm**




# HMC272AMS8 / 272AMS8E

## GaAs MMIC SMT SINGLE BALANCED MIXER, 1.7 - 3.0 GHz

### MxN Spurious Outputs

mRF	nLO				
	0	1	2	3	4
0	xx	-11	-6	5	19
1	7	0	37	27	38
2	53	64	62	46	72
3	83	>85	>85	>85	>85
4	>85	>85	>85	>85	>85

RF = 2.6 GHz @ -10 dBm  
 LO = 2.2 GHz @ +13 dBm  
 All values in dBc relative to the IF

### Harmonics of LO

LO Frequency (GHz)	nLO Spur at RF Port			
	1	2	3	4
1.5	37	14	36	41
1.7	35	12	37	48
1.9	35	13	43	49
2.1	43	16	42	49
2.3	36	19	37	49
2.5	29	23	36	50

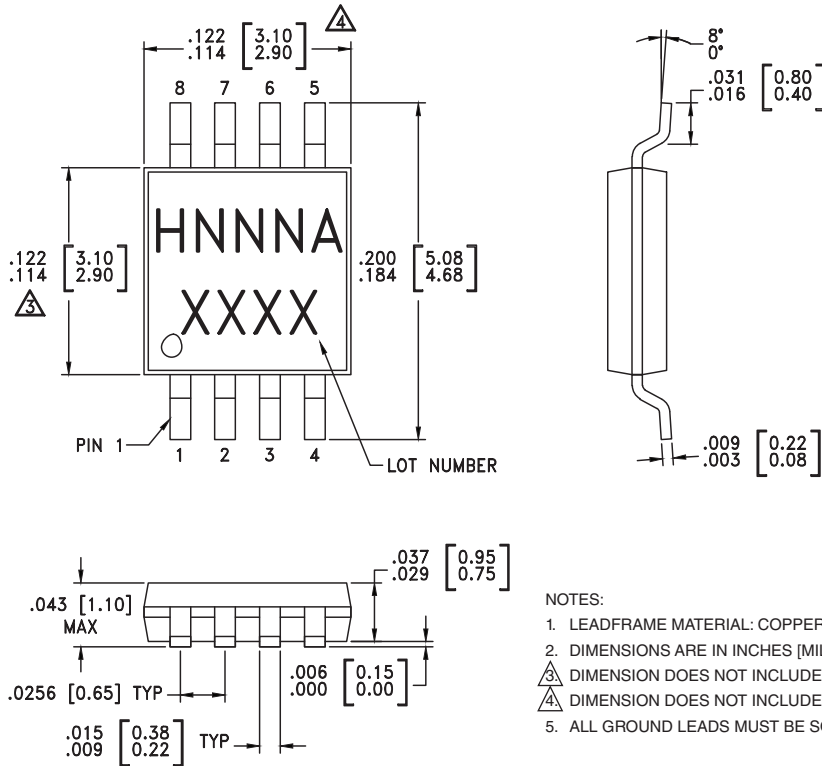
LO = +10 dBm  
 Values in dBc below input LO level measured at the RF port.

### Absolute Maximum Ratings

RF / IF Input	+13 dBm
LO Drive	+27 dBm
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A



ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

**Outline Drawing**

**NOTES:**

1. LEADFRAME MATERIAL: COPPER ALLOY
2. DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
- △ DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.15mm PER SIDE.
- △ DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLDFLASH OF 0.25mm PER SIDE.
5. ALL GROUND LEADS MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.

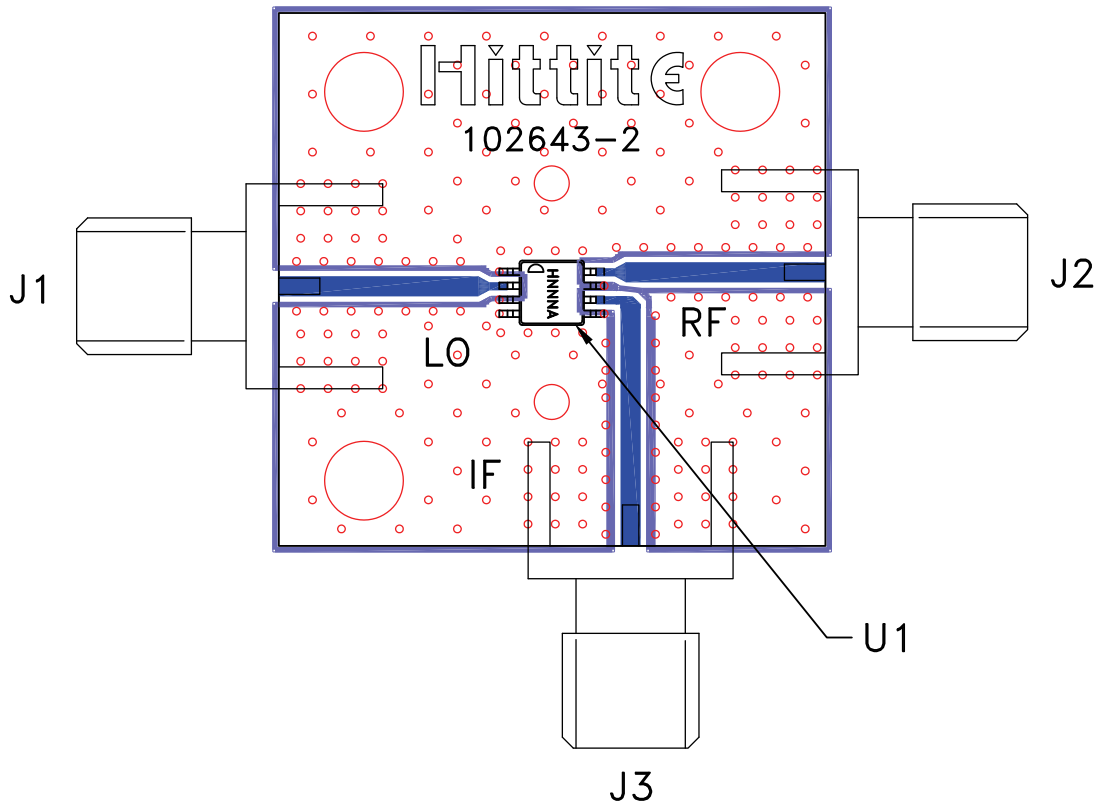
**Package Information**

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking <sup>[3]</sup>
HMC272AMS8	Low Stress Injection Molded Plastic	Sn/Pb Solder	MSL1 <sup>[1]</sup>	H272A XXXX
HMC272AMS8E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 <sup>[2]</sup>	H272A XXXX

[1] Max peak reflow temperature of 235 °C

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C

[3] 4-Digit lot number XXXX

**Evaluation Circuit Board**

**List of Materials for Evaluation PCB 102781 [1]**

Item	Description
J1 - J3	PCB Mount SMA RF Connector
U1	HMC272AMS8 / HMC272AMS8E Mixer
PCB [2]	102643 Evaluation Board

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9